

国泰君安证券股份有限公司

关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2023 年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“敏芯股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责敏芯股份的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导工作制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与公司签订了《保荐协议》，约定了保荐机构在持续督导期内，持续督导公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式，了解公司业务情况，开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年度，敏芯股份在持续督导期间内未发生按照有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规事项
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023 年度，敏芯股份在持续督导期间内未出现违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项	2023 年度，保荐机构在持续督导期间内督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证

序号	工作内容	持续督导情况
	承诺	券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构在持续督导期间内督导公司建立健全并有效执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构在持续督导期间内对公司内部控制制度的设计、实施和有效性进行了核查，公司的内控制度符合相关法规的要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构在持续督导期间内督导上市公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构在持续督导期间内对公司的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2023年度，敏芯股份或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在持续督导期间内不存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2023年度，敏芯股份及其控股股东、实际控制人在持续督导期间内不存在未履行承诺事项的情况
13	关注社交媒体关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时	2023年度，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况

序号	工作内容	持续督导情况
	督促上市公司如实披露或予以澄清，上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023年度，敏芯股份在持续督导期间内未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的工作计划，明确了现场检查的工作要求
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2023年度，敏芯股份在持续督导期间内不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

（一）发现的风险

2023年度，公司实现营业总收入 37,266.26 万元，同比增长 27.34%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,184.67 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,998.71 万元，主要原因系：（1）行业竞争加剧，价格竞争激烈，部分产品单价出现下滑，导致公司产品综合毛利率下降；（2）IPO 募投项目完成投资，整体资产折旧摊销及运营成本增加，相关投入效益尚待在以后报告期逐步增加。

（二）整改情况

上述问题不涉及整改事项。保荐机构提请公司做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

三、重大风险事项

2023 年度，公司实现营业总收入 37,266.26 万元，同比增长 27.34%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,184.67 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,998.71 万元，主要原因系：（1）行业竞争加剧，价格竞争激烈，部分产品单价出现下滑，导致公司产品综合毛利率下降；（2）IPO 募投项目完成投资，整体资产折旧摊销及运营成本增加，相关投入效益尚待在以后报告期逐步增加。

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

由于受到地缘政治的紧张局势、消费类电子市场整体表现低迷等因素的影响，导致部分消费类终端品牌出货量下滑，进而影响上游元器件供应厂商的出货，对公司的主营业务出货量及产品价格均产生较大的影响。公司主力产品 MEMS 声学传感器的行业整体产能充足，行业竞争加剧，使得公司业绩出现下滑。如未来公司出现研发投入未能及时转化为研发成果或研发成果未能及时产业化，或公司销售拓展成果未能及时显现等情形，将使公司未来一定期间内仍存在业绩大幅下滑、继续亏损的风险。

（二）核心竞争力风险

1、新产品研发风险

MEMS 传感器作为信息获取和交互的关键器件，随着物联网和人工智能技术的不断发展，新的应用场景层出不穷，为适应市场新的应用和快速发展，公司需要根据技术发展的趋势和下游客户的需求不断升级更新现有产品和研发新技术和新产品，从而保持技术的先进性和产品的竞争力。但由于 MEMS 传感器产品的基础研发周期较长，而研发成果的产业化具有一定的不确定性，如果产品研发进度未达预期或无法在市场竞争中占据优势，公司将面临新产品研发失败的风险，前期的研发投入也将无法收回。

2、人才团队建设风险

MEMS 芯片设计涉及较多跨学科知识和跨行业技术的融合，包括机械、电子、材料、半导体等多门学科，对人才水平的要求较高，而 MEMS 产业商业化时间较短，中国的 MEMS 产业 2009 年才逐渐起步，行业内的优秀人才较为短缺，尤其是具备芯片设计和技术前瞻性判断的高端人才。随着 5G 的推广和物联网的发展，MEMS 传感器下游应用领域快速扩张，行业内公司加大对专业人才的招揽力度。公司作为一家拥有 MEMS 传感器芯片自主研发能力的半导体芯片设计企业，专业人才是公司保持持续研发能力的重要资源，如果公司的人才培养、引进不能满足公司业务发展的需要，则会对公司持续经营和长期发展带来不利影响。

3、技术复制或泄露风险

MEMS 行业是技术密集型行业，核心技术是企业保持竞争力的关键。公司经过十余年的研发积累，在各条 MEMS 产品线的芯片设计、晶圆制造、封装和测试等环节都拥有了自己的核心技术。目前，公司还在持续对新技术和新产品进行研发，尽管公司已与研发人员签订了保密协议，但仍存在因核心技术保管不善或核心技术人员流失等原因导致核心技术泄密的风险，而在与供应商合作的过程中，公司也需要与供应商共享晶圆制造和封装的技术工艺，因此存在技术被复制或泄露的风险。

（三）经营风险

1、产品结构风险

公司目前的主要产品包括 MEMS 声学传感器、MEMS 压力传感器和 MEMS 惯性传感器。其中，MEMS 声学传感器的销售收入占主营业务收入的比例较高，单一产品收入的占比较高。虽然公司正在研究和开发新的 MEMS 传感器产品，并积极进行市场推广，但在短期内，如果 MEMS 声学传感器的需求增速放缓，将会对公司的营收和盈利能力带来不利影响。

2、经营模式风险

公司专注于 MEMS 传感器的研发与设计，将完成的芯片设计交付中芯国际、华润上华等国内知名的晶圆厂商进行晶圆制造，并自主完成或委托华天科技等专业的封装测试厂商完成封装测试。公司与中芯国际、华润上华和华天科技等行业内主要的晶圆制造厂商和封装厂商均建立了长期合作关系，但若未来晶圆制造、封装供应商及公司自主产线的产能不足，或者晶圆和委外加工市场价格大幅上涨，将会对公司的产品出货和盈利能力造成不利影响。

3、技术人才流失风险

公司所处行业具有人才密集型特征，是一个涉及多学科跨领域的综合性行业。技术人员对于新产品设计研发、产品成本控制以及提供稳定优质的技术服务具有至关重要的作用。随着市场需求的不断增长，行业竞争的日益激烈，企业之间人才竞争也逐渐加剧，公司现有技术人才亦存在流失的风险。如果公司不能持续加强技术人才的激励和保护力度，则存在一定的技术人才流失风险。

4、产品质量控制的风险

产品质量是公司客户关心的核心属性，公司严格按照国家相关法律法规建立了产品质量管理体系，确保每批产品均符合行业及客户质量标准和相关要求。由于公司产品的生产工艺复杂，产品质量受较多因素影响。如果在生产控制、产品测试、存储运输等过程出现偶发性或设施设备故障、人为失误等因素，将可能导致质量问题的发生，从而影响公司产品对客户的交付。

5、安全生产的风险

在生产过程中，若因自然灾害、流程设计缺陷、设施设备质量隐患、违章指挥、防护缺失、设备老化或操作失误、工作疏忽等原因，可能会导致设施设备损坏、产品报废或人员伤亡等安全生产事故的发生，从而对公司正常生产经营造成不利影响。

（四）财务风险

1、毛利率下降风险

消费电子产品更新换代速度较快，竞争也较为激烈，半导体芯片设计企业需要根据下游市场需求不断进行产品的迭代升级和创新。一般情况下，率先推出顺应下游发展趋势产品的企业在市场上享有较高的定价权，毛利率相对较高，但随着同类产品陆续推向市场，市场竞争的加剧和消费电子厂商对成本管控的要求使得产品价格下降，毛利率空间也被逐渐压缩，2023年度公司综合毛利率为16.81%。2023年，行业整体产能充足，行业竞争加剧，价格竞争更为激烈，部分产品的单价出现下滑，导致公司产品综合毛利率下降。此外，在公司顺应MEMS传感器市场发展趋势、不断开发新产品的过程中，新产品在投入量产初期可能存在工艺磨合和生产稳定性提升等问题，在短期内可能对公司毛利率造成不利影响。

2、存货跌价风险

2023年12月末，公司存货账面余额为19,954.34万元，存货跌价准备余额为2,584.37万元，存货跌价准备余额占存货账面余额的比例为12.95%。由于存货周转期较长以及部分产品价格下滑，导致部分存货的预计可变现净值低于成本，公司基于谨慎角度考虑，对预计可变现净值低于成本的存货计提了存货跌价准备。如果未来下游客户需求、市场竞争格局发生变化，或者公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，就可能导致存货无法顺利实现销售，从而使公司存在增加计提存货跌价准备的风险。若因产品检测不合格或者原材料未在保质期内使用，则存在存货失效报废的风险。

（五）行业风险

1、下游应用领域发展趋势变化风险

由于公司坚持以市场为导向的研发与营销策略，下游应用领域的发展趋势是影响公司业绩增长的重要因素。在消费类电子领域，手机、TWS耳机、智能音箱等IoT设备的市场变化迅速，如上述市场不能保持快速增长趋势甚至下滑，或者如公司不能根据下游应用领域发展趋势的变化不断推出顺应下游新兴市场需求的的产品，或无法在现有市场地位的基础上进一步开发主流消费电子领域的品牌客户，将对公司业绩造成不利影响。

2、行业竞争加剧风险

随着 5G 技术的推广和物联网的不断发展，使用 MEMS 技术生产相关器件已成为趋势，新的器件品类不断涌现，应用场景的丰富也使得 MEMS 产品出货量保持较快增速，并且由于公司在国内 MEMS 领域的耕耘，国内 MEMS 产业链进一步成熟，这吸引了众多大型企业进入 MEMS 行业，存在行业竞争加剧的风险。公司作为 MEMS 传感器芯片的自主研发企业，如不能持续提升技术和产品的研发能力，将因为市场竞争加剧面临较大不确定性。在我国大力支持和发展芯片产业、MEMS 生产体系逐渐成熟的背景下，如更多的国内企业具备 MEMS 传感器芯片设计和研发能力，或通过外购芯片的方式实现产品出货，市场竞争将进一步加剧。

（六）宏观环境风险

半导体行业是面临全球化的竞争与合作并得到国家政策大力支持的行业，受到国内外宏观经济、行业法规和贸易政策等宏观环境因素的影响。近年来，全球宏观经济表现平稳，国内经济稳中有升，国家也出台了相关的政策法规大力支持半导体行业和传感器技术的发展，MEMS 传感器行业快速增长。未来，如果国内外宏观环境因素发生不利变化，如中美贸易摩擦进一步升级，可能造成半导体材料供应和下游需求受限，从而对公司经营带来不利影响。

（七）其他风险

在技术高度密集的半导体领域，为了保持技术优势和竞争力，建立核心专利壁垒已经成为产业共识。在半导体芯片设计领域，已掌握领先技术的企业会通过及时申请专利的方式形成核心技术护城河，并运用专利维权，向竞争对手发起专利战。知识产权诉讼，尤其是专利诉讼已成为阻碍竞争对手经营发展的重要策略。公司自设立以来一直坚持 MEMS 传感器产品的自主研发与设计，在各条产品线的芯片制造、封装和测试等环节都拥有了自己的核心技术。公司高度重视知识产权管理，制定了专门的知识产权管理制度。虽然公司已采取了严格的知识产权保护措施，但仍然存在部分核心技术被竞争对手模仿或诉讼的可能性。

2019 年 7 月以来，歌尔股份及其子公司采用多种方式对公司发起专利战，包括以公司侵害其专利权为由向法院提起诉讼、主张公司自竞争对手处离职的员工在离职一年内申请的专利为其在原工作单位的职务发明、对公司专利提出无效

宣告请求等。如公司在相关诉讼中被认定为侵权并承担相应的赔偿责任，可能对公司业绩造成不利影响；如相关专利被认定为对方的职务发明或被无效，公司该等专利存在被对方使用或模仿的风险。关于公司诉讼与专利无效事项的进展情况详见公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《首次公开发行股票科创板上市公告书》、定期公告和临时公告。

四、重大违规事项

2023 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

主要会计数据	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度
营业收入（元）	372,662,562.13	292,650,210.87	27.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-101,846,686.52	-55,028,812.77	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-109,987,067.11	-66,296,888.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,586,818.15	-21,689,545.14	不适用
主要会计数据	2023 年末	2022 年末	增减变动幅度
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,068,689,813.22	1,027,961,917.41	3.96%
总资产（元）	1,225,523,930.42	1,167,525,916.08	4.97%
主要财务指标	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度
基本每股收益（元/股）	-1.90	-1.04	不适用
稀释每股收益（元/股）	-1.90	-1.04	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-2.05	-1.25	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-10.21	-5.19	减少 5.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-11.02	-6.26	减少 4.76 个百分点
研发投入占营业收入的	20.91	23.83	减少 2.92 个百分点

比例 (%)			
--------	--	--	--

上述主要财务数据及指标的变动原因与合理性情况如下：

归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 4,681.79 万元，主要原因系：

(1) 行业整体产能充足，行业竞争加剧，价格竞争更为激烈，部分产品的单价出现下滑，导致公司产品综合毛利率下降；(2) IPO 募投项目投资完成，整体资产折旧摊销及运营成本增加，相关投入效益尚待在以后报告期逐步增加。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 4,369.02 万元，主要原因系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期净流出减少 1,210.27 万元，主要原因系报告期内销售收入增加以及有效控制存货，使得净利润亏损增加的情况下现金净流出减少。

基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别减少 0.86 元、0.86 元、0.80 元，主要原因系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致。

六、核心竞争力的变化情况

(一) 强大的自主研发及创新优势

公司自成立以来一直专注于 MEMS 传感器的自主研发与设计，经过十余年的研发投入，公司在 MEMS 传感器芯片设计、晶圆制造、封装和测试等各生产环节都拥有了自主研发能力和核心技术积累。与采用标准 CMOS 工艺的大规模集成电路行业专业化分工程度高，研发难度集中于设计端相比，MEMS 行业在芯片设计、晶圆制造、封装和测试各环节均有着较强的研发难度和壁垒。公司在产品各生产环节的自主研发与设计领域的技术优势为未来持续升级现有产品线和研发新的 MEMS 产品奠定了基础。

公司作为一家专注于 MEMS 传感器自主研发与设计的企业，一直重视技术的持续创新能力。公司秉承“量产一代，设计一代，预研一代”的研发策略，在产品达到可量产状态的同时，就开始用下一代技术研发新的产品，根据技术发展

的趋势和下游客户的需求不断对现有产品进行升级更新，并利用自身在 MEMS 传感器领域积累的技术和工艺扩展新的产品线。

公司是国内少数在 MEMS 声学传感器、MEMS 压力传感器和 MEMS 惯性传感器领域均具有芯片自主设计能力的公司，经过多年的行业经验和技術积累，MEMS 声学传感器产品尺寸、灵敏度和灵敏度公差等多项性能指标已处于行业前列，公司的行业地位和研发实力也得到了业内主要机构的认可。

（二）人才与团队优势

MEMS 是一门交叉学科，MEMS 传感器的研发与设计需要机械、电子、材料、半导体等跨学科知识的积累和跨行业技术的整合，对研发人员的专业水平要求较高。

公司创始人、董事长及总经理李刚博士毕业于香港科技大学微电子技术专业，具有多年 MEMS 行业研发与管理经验，是超过 50 项 MEMS 专利的核心发明人，于 2007 年 9 月获得苏州工业园区“首届科技领军人才”称号。公司创始人及副总经理胡维毕业于北京大学微电子学专业，负责主导 MEMS 传感器芯片的设计与制造工艺的研发。公司创始人及副总经理梅嘉欣毕业于南京大学微电子学与固体电子学专业，负责主导 MEMS 传感器的封装和测试工艺的研发。三位核心技术人员的从业经历超过 10 年，在 MEMS 传感器芯片设计、制造、封装和测试等环节都有着深厚的技术积累。

公司高度重视研发人员的培养，建立了学历高、专业背景深厚、创新能力强的研发团队。除研发设计外，公司在市场营销、生产运营、品质保证和售后服务等团队的核心人员均拥有多年 MEMS 行业的工作经历，积累了丰富的运营和管理经验。

（三）本土化经营优势

MEMS 传感器的生产环节主要包括 MEMS 传感器芯片设计、晶圆制造、封装和测试。公司自设立起就坚持 MEMS 传感器芯片的自主研发与设计，并在成立之初国内缺乏成熟和专业的 MEMS 生产体系的情况下，经过十余年的研发和生产体系构建投入，完成了 MEMS 传感器芯片设计、晶圆制造、封装和测试各

环节的基础研发工作和核心技术积累，并深度参与了国内第三方半导体制造厂商 MEMS 加工工艺的开发，从而实现了 MEMS 产品全生产环节的国产化。公司晶圆的主要供应商为中芯国际、中芯绍兴和华润上华，均是国内知名的晶圆制造厂商，封装测试主要由公司自主完成或委托华天科技等国内知名的半导体封装测试厂商完成，公司已构建专业的 MEMS 传感器产品封装和测试线，在 MEMS 生产体系上进一步拓展，不断增强自主封装测试能力，为公司产品升级、新工艺产业化、提升 MEMS 产能奠定基础，更好的满足高端客户需求，产品竞争力不断提升。公司本土化的经营模式使公司在产品成本与性价比、供应商协同合作和客户支持与服务等方面具有明显优势。

（四）品牌与客户资源优势

公司的主要产品为 MEMS 声学传感器、MEMS 压力传感器和 MEMS 惯性传感器，主要应用于消费电子、汽车和医疗等领域。

报告期内，公司的 MEMS 声学传感器产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能家居、可穿戴设备等消费电子产品，具体品牌包括华为、传音、小米、三星、OPPO、联想等。公司的 MEMS 压力传感器产品主要应用于消费电子、汽车和医疗领域，其中电子血压计终端客户主要包括乐心医疗和九安医疗等。

公司凭借较高的产品性能和性价比积累了优质的客户资源和良好的品牌知名度，与客户建立了稳定的合作关系，有利于公司未来进一步的业务和客户扩展。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2023 年度，公司研发费用为 7,790.71 万元，同比增长 11.70%。2023 年度，公司研发费用占营业收入的比例为 20.91%，较 2022 年度减少 2.92 个百分点。

（二）研发进展

MEMS 本质上是一种微制造技术，芯片结构与工艺实现之间密不可分，二者同时构成 MEMS 企业的核心竞争壁垒。公司从成立伊始就紧紧围绕芯片端的上述核心竞争要素进行研发并建立了突出优势。

公司制定了成为“行业领先的 MEMS 芯片平台型企业”的发展目标，从芯片上游溯源，选择下游器件和模组市场容量或潜力较大的 MEMS 芯片种类进行研发，自芯片端确定研发方向，再根据下游应用场景的需要，有针对性的在封装和测试端进行后段研发。

在声学 MEMS 芯片及传感器、压力传感器芯片及传感器、模组、惯性传感器芯片、压感传感器芯片、流量传感器芯片、微流控生物检测芯片、MEMS 光学传感器、压电超声换能器（PMUT）等领域取得了研发进展，并在 MEMS 多轴力传感器、MEMS 微流控芯片、MEMS 光学传感器、MEMS 惯性传感器、数字 MEMS 麦克风传感器、骨传导传感器、压电超声换能器（PMUT）、MEMS 扬声器、高度计传感器等领域进行技术布局。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

公司专注于 MEMS 传感器的研发、生产与销售，围绕 MEMS 领域进行技术与产品创新。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）首次公开发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目		金额
募集资金净额		73,232.09
截至期初累计发生额	项目投入金额	58,345.12
	理财收益与利息收入净额	1,910.33
本期发生额	项目投入金额	15,690.10
	理财收益与利息收入净额	161.52
截至期末累计发生额	项目投入金额	74,035.22
	理财收益与利息收入净额	2,071.85
募集资金期末余额		1,268.72

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	10551301040054442	22,120.25	募集资金户
招商银行苏州中新支行	512903602710907	1,569,877.54	募集资金户
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122001348411	128,912.69	募集资金户
中国民生银行姑苏支行	632235885	4,050,540.14	募集资金户
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801600004643	8,183.64	募集资金户
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512908786510803	6,595,838.98	募集资金户
中国农业银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	10551301040054723	311,682.66	募集资金户
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122001362827	-	募集资金户
合计		12,687,155.90	

(二) 以简易程序向特定对象发行股票

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目		金额
募集资金净额		12,306.84
截至期初累计发生额	项目投入金额	-
	理财收益与利息收入净额	-
本期发生额	项目投入金额	-
	理财收益与利息收入净额	1.25
截至期末累计发生额	项目投入金额	-
	理财收益与利息收入净额	1.25
待支付及未置换的发行费用扣除承销保荐费坐扣金额包含的税金		83.15
募集资金期末余额		12,391.24

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
宁波银行股份有限公司苏州分行	86021110000074063	6,444.44	募集资金户

宁波银行股份有限公司苏州分行	86021110000076100	3,905,970.37	募集资金户
宁波银行股份有限公司苏州分行	86021110000080037	40,000,000.00	募集资金户
宁波银行股份有限公司苏州分行	86023000000122160	80,000,000.00	结构性存款
合计		123,912,414.81	

2023 年度，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，除存在误操作情况外，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

公司控股股东、实际控制人李刚直接持有公司 19.23%的股份；作为苏州昶恒企业管理咨询企业（有限合伙）的执行事务合伙人控制公司 1.68%的股份；作为苏州昶众企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人控制公司 3.31%的股份。

根据公司于 2023 年 3 月 11 日和 2023 年 5 月 26 日公告的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董监高减持股份进展公告》，2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 10 日期间，公司高级管理人员张辰良通过大宗交易方式减持 62,700 股，减持股份数量占公司总股本的 0.12%。

根据公司于 2023 年 7 月 8 日公告的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司董监高集中竞价减持股份结果公告》，2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 7 日期间，公司高级管理人员董铭彦和钱祺凤分别通过集中竞价交易方式减持 4,300 股和 1,400 股，减持股份数量分别占公司总股本的 0.008%和 0.0026%。

除上述情况外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况未发生变动，持有的股份不存在质押、冻结及减持的情形。


十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



周大川



王拓

